证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临2024-099

赛轮集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次被担保人名称：赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供2亿元、2亿元、5,000万元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供48.89亿元、2亿元、5.50亿元连带责任担保。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保未发生逾期情形

● 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为228亿元，截至本公告披露日实际发生担保额为177.82亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的153.50%、119.72%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为92.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.60%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年12月13日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮集团”）召开第六届董事会第十六会议，审议通过了《关于2024年度预计对外担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过121亿元（若未特别标注币种、则为人民币）担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司之间为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。上述事项亦经公司2023年12月29召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月27日，为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》，拟调整公司为控股子公司提供担保的额度，由总额不超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保），有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。上述事项亦经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月14日、2023年12月30日、2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度预计对外担保的公告》（公告编号：临2023-031）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-119）、《关于调整2024年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：临2024-037）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

2024年11月6日，根据业务发展需要，公司分别为全资子公司赛轮轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）、赛轮（东营）轮胎股份有限公司（以下简称“赛轮东营”）与赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）提供连带责任保证担保，本次担保涉及金额及合同签署时间在第六届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议范围内，无需再次履行审议程序，具体情况如下：

日期	债权人	债务人	保证人	文件名称	担保金额
2024年11月6日	商业银行一	赛轮销售	赛轮集团	《最高额保证合同》	2亿元
	商业银行二	赛轮东营		《保证合同》	2亿元
	商业银行三	赛轮沈阳		《最高额保证合同》	5,000万元

公司本次为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供2亿元、2亿元、5,000万元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳分别提供48.89亿元、2亿元、5.50亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）赛轮销售

统一社会信用代码：91370211756911074M

注册地址：山东省青岛市黄岛区淮河东路北宫源工业园6号路

法定代表人：刘燕华

注册资本：105,000万元

经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：赛轮销售为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据（单体报表数据）：

单位：万元

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,059,693.20	1,190,991.97
归母净利润	6,601.76	121.53
	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总计	906,550.93	668,581.40
负债总计	778,750.59	547,815.56
归母净资产	127,800.34	120,765.84

（二）赛轮东营

统一社会信用代码：91370500672240568W

注册地点：山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号

法定代表人：朱汉卿

注册资本：48,000万元

经营范围：轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售；胶管生产、销售；轮胎生产技术咨询服务及转让；广告、设计制作；房屋租赁；经核准的自营进出口业务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	赛轮集团股份有限公司	99.625%
2	赛轮轮胎销售有限公司（公司全资子公司）	0.375%

最近一年及一期财务数据（单体报表数据）：

单位：万元

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	370,531.03	372,528.34
归母净利润	49,315.84	25,712.73
	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总计	428,427.04	358,417.09
负债总计	124,466.70	104,318.09
归母净资产	303,960.34	254,099.00

（三）赛轮沈阳

注册地点：沈阳化学工业园沈西三东路2号

法定代表人：刘汉军

注册资本：72,000万元

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务；化工产品及原料销售（不含易燃易爆危险品）；进出口业务及相关服务（国家限定和禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：赛轮沈阳为公司全资子公司

最近一年及一期财务数据（单体报表数据）：

单位：万元

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	270,756.97	337,412.80
归母净利润	12,359.48	8,897.23
	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总计	608,269.77	494,700.65
负债总计	480,487.23	380,150.38
归母净资产	127,782.54	114,550.27

三、担保合同主要内容

（一）担保合同一

1、债权人：商业银行一

2、债务人：赛轮销售

3、保证人：赛轮集团

4、担保金额：不超过2亿元

5、保证范围：本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

8、是否存在反担保：否

（二）担保合同二

1、债权人：商业银行二

2、债务人：赛轮东营

3、保证人：赛轮集团

4、担保金额：不超过2亿元

5、保证范围：本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

8、是否存在反担保：否

（三）担保合同三

1、债权人：商业银行三

2、债务人：赛轮沈阳

3、保证人：赛轮集团

4、担保金额：不超过5,000万元

5、保证范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等）和其他所有应付费用。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；如果债权人要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年；债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任，如任何一笔主债权为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年；如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

8、是否存在反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳日常生产经营需要，当前赛轮销售、赛轮东营、赛轮沈阳经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第六届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保及逾期情况

公司及控股子公司预计年度对外担保总额为228亿元（为年度担保预计时，公司对控股子公司、控股子公司对公司、子公司之间的担保总和），截至本公告披露日实际发生担保额为177.82亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的153.50%、119.72%；公司对全资子公司预计年度担保总额为132亿元，截至本公告披露日实际发生担保额为106.12亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的88.87%、71.45%，其中公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为92.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.60%。

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024年11月7日

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-043

浙江东尼电子股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于浙江东尼电子股份有限公司2024年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】3487号，以下简称“《监管工作函》”）。

公司按照《监管工作函》的要求，积极组织有关各方对涉及的问题进行了逐项分析和研究，结合公司的实际情况，现将回复内容公告如下：

如无特别说明，本回复中的简称与《东尼电子2024年半年度报告》的简称具有相同含义。本回复中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，这些差异均由于四舍五入造成。

1.公告显示，2023年、2024年半年度公司归母净利润分别为-6.07亿元、-0.67亿元，亏损主要系针对存货计提大额资产减值损失，其中2023年计提存货跌价准备4.63亿元，2024年半年度再次计提1.15亿元，合计达5.78亿元。截至2024年6月末，公司库存商品、半成品账面价值仅有1.21亿元、0.99亿元，而相应的跌价准备则分别高达3.34亿元、0.99亿元。

请公司补充披露：（1）分产品类别和应用领域列示2023年末、2024年6月末公司库存商品、半成品的具体构成和变动情况；（2）结合2023年以来主要产品的销售情况，说明各产品类别存货减值迹象出现的具体时点，各季度存货跌价准备的计提依据和测算过程，说明2023年至2024年半年度存货跌价计提是否及时、充分；（3）结合现有业务开展情况，说明相关存货是否存在进一步减值风险，如是请充分提示。请年审会计师对2023年度相关事项发表意见。

【公司回复】

（1）分产品类别和应用领域列示2023年末、2024年6月末公司库存商品、半成品的具体构成和变动情况

1.公司2023年末、2024年6月末的库存商品、半成品具体构成如下：

单位：万元

报告期	存货项目	产品类别和应用领域	账面余额	存货跌价准备	账面价值
2024年6月末	库存商品	消费电子	3,654.92	172.10	3,482.82
		光伏	2,813.13	1,670.12	1,143.02
		新能源	3,299.36	168.69	3,130.67
		医疗	741.48		741.48
		半导体	34,982.63	31,397.00	3,585.63
		合计	45,491.52	33,407.91	12,083.61
	半成品	消费电子	1,033.99	41.09	992.90
		光伏	8,400.81	2,429.52	5,971.29
		新能源	1,870.99	202.43	1,668.55
		医疗	661.49		661.49
		半导体	7,962.88	7,313.91	648.97
		合计	19,930.16	9,986.96	9,943.20
2023年末	库存商品	消费电子	3,438.10	181.48	3,256.62
		光伏	3,187.15	2,313.99	873.16
		新能源	2,883.87	100.99	2,782.88
		医疗	869.54		869.54
		半导体	26,742.48	20,142.56	6,599.92
		合计	37,121.13	22,739.02	14,382.12
	半成品	消费电子	1,346.33	20.04	1,326.29
		光伏	7,916.26	2,636.11	5,280.16
		新能源	1,683.66	202.59	1,481.07
		医疗	821.96		821.96
		半导体	7,558.06	5,757.01	1,801.05
		合计	19,326.28	8,615.75	10,710.53

2.公司2023年末、2024年6月末的库存商品、半成品变动情况如下：

单位：万元

存货项目	产品类别和应用领域	2024年6月末账面余额	2023年末账面余额	变动金额	变动比例（%）
库存商品	消费电子	3,654.92	3,438.10	216.82	6.31
	光伏	2,813.13	3,187.15	-374.02	-11.74
	新能源	3,299.36	2,883.87	415.49	14.41
	医疗	741.48	869.54	-128.06	-14.73
	半导体	34,982.63	26,742.48	8,240.15	30.81
	合计	45,491.52	37,121.13	8,370.39	22.55
半成品	消费电子	1,033.99	1,346.33	-312.34	-23.20
	光伏	8,400.81	7,916.26	484.55	6.12
	新能源	1,870.99	1,683.66	187.33	11.13
	医疗	661.49	821.96	-160.47	-19.52
	半导体	7,962.88	7,558.06	404.82	5.36
	合计	19,930.16	19,326.28	603.88	3.12

（2）结合2023年以来主要产品的销售情况，说明各产品类别存货减值迹象出现的具体时点，各季度存货跌价准备的计提依据和测算过程，说明2023年至2024年半年度存货跌价计提是否及时、充分

1.公司2023年以来主要产品分类别销售情况如下：

单位：万元

主要产品	2024年第二季度	2024年第一季度	2023年第四季度	2023年第三季度	2023年第二季度	2023年第一季度
消费电子	18,325.26	19,508.66	27,274.96	30,652.41	15,001.53	14,400.72
光伏	6,991.54	5,955.35	8,254.58	13,350.87	12,743.75	10,811.48
新能源	7,233.38	6,640.92	4,998.43	4,412.60	3,312.72	2,101.44
医疗	3,464.30	2,728.31	2,783.92	3,060.41	3,136.65	2,252.87
半导体	1,225.84	2,903.50	1,935.57	75.81	8,495.43	2,434.10
合计	37,240.31	37,736.75	45,247.46	51,552.10	42,690.08	32,000.62

2.公司2023年以来各产品类别各季度的存货跌价准备期末余额如下：

单位：万元

主要产品	2024年6月末	2024年3月末	2023年末	2023年9月末	2023年6月末	2023年3月末
消费电子	311.56	255.56	344.24	158.94	182.22	202.79
光伏	5,477.11	6,331.67	7,129.81	2,077.86	2,245.84	3,448.89
新能源	404.68	414.79	535.10	271.43	289.26	324.82
医疗						
半导体	45,093.23	39,570.25	38,718.59	28,192.36	2,560.38	4,409.14
合计	51,286.58	46,572.26	46,727.73	30,700.59	5,277.71	8,385.64

公司主要产品存货减值迹象出现的具体时点分析如下：

公司根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，每季度末进行存货跌价准备的测算和计提，公司存货跌价准备主要在半导体和光伏业务。

半导体业务系2023年初开始批量供货的新项目，2023年第三季度因客户检测设备更换，主营业务收入出现下滑，且部分在产品只能作为低等级的调机片处理，相比正常合格品订单售价大幅下降，该业务于2023年第三季度计提大额存货跌价准备；2023年第四季度至2024年第二季度该业务仍有存货跌价准备的计提主要系2024年公司碳化硅衬底的售价下降且当期产品良率不稳定、生产成本偏高所致。

光伏业务的主营业务收入在2023年前三季度呈增长趋势，第四季度受到产业链主要产品价格下跌的影响，公司产品售价大幅下降，主营业务收入出现下滑，该业务于2023年第四季度计提大额存货跌价准备，其他季度光伏业务的存货跌价准备较为平稳，未发生明显波动。

3、存货跌价准备的计提依据和测算过程

公司根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

企业确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司存货可变现净值确认过程及方法如下：

（1）原材料：正常生产流转的原材料，因产成品预计售价导致的存货跌价，根据产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本（以在产品完工程度体现）、估计的销售费用（按照销售费用占同期收入的比重）后的金额，确定其可变现净值；对不可继续用于后续生产的按照市场处置价确认。

（2）半成品：对于在生产使用过程中的在产品，以产成品售价为基础减去至完工时估计将要发生的成本（以在产品完工程度体现）、估计的销售费用（按照销售费用占同期收入的比重）后的金额确认，确定其可变现净值；对于处于再加工状态的退货产品，按照调机片售价为基础，减去估计的销售费用以及达到可销售状态尚需投入的成本后的金额确认；对于在产品中已呆滞报废的物料，按照市场处置价确认。

（3）库存商品：按照产品售价为基础减去估计的销售费用（按照销售费用占同期收入的比重）以及达到可销售状态尚需投入的成本后的金额，确定其可变现净值。

（4）发出商品：对于发出商品有合同或订单的正常销售商品，按其签订的销售价格合理确定其可变现净值；对于发出商品中涉及期后退货的部分，在客户退回时，按照产成品中退货产品的预计售价确认。

2023年第三季度，半导体业务部分在产品因客户检测设备更换，只能作为调机片处理，相比正常合格品订单售价大幅下降80%；2024年公司碳化硅衬底合格片的售价下降20%-32%；2023年第四季度，光伏业务售价出现大幅下降，（以某客户某规格产品报价为例，2023年12月含税单价相比2023年9月下降约40%）。而存货跌价准备的计提=存货结存数量*（单位成本-单位可变现净值），单位可变现净值=不含税销售单价*（1-销售费用率）-达到可销售状态尚需投入的成本，售价的下降使得单位可变现净值下降，从而导致对应季度的存货跌价准备的计提大幅增加（以2023年第三季度被作为调机片处理的碳化硅衬底为例，该规格因售价大幅下降80%，导致单位可变现净值仅为其单位成本的约11%，计提了存货跌价准备约2.08亿元）。

综上，公司2023年至2024年半年度存货跌价计提及时、充分。

（3）结合现有业务开展情况，说明相关存货是否存在进一步减值风险，如是请充分提示

2024年开始，公司半导体业务主要进行高规格6英寸和8英寸衬底的研发验证工作，截至2024年9月末，该业务尚未大规模生产供货，在新工艺参数调试过程中，产品良率不稳定，生产成本偏高。2024年半年度，公司已按照在手订单的售价充分计提存货跌价准备。未来公司相关订单的售价会根据市场行情与客户协商情况进行调整，如果产品售价下跌或未来良率得不到有效提升，该业务相关存货仍存在进一步减值风险。

除半导体业务以外的其他业务，公司已于2024年半年度对相关存货按照在手订单的售价充分计提减值准备，目前暂无计提大额存货跌价准备的风险，但如果未来出现产品售价下跌或生产成本上升的情况，相关存货可能存在进一步的减值风险。

【年审会计师意见】

公司2023年末库存商品、半成品的构成合理，与公司实际情况相符。

公司根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，定期进行存货跌价准备的测算和计提。我们复核了公司期末存货跌价准备的计算过程及结果，其依据是充分的，具有合理性，公司2023年末存货跌价准备计提及时、充分。

2.公告显示，因存在部分原材料未及时入账、研发费用错误确认为半成品等情况，公司进行会计差错更正，将2022年归母净利润由1.08亿元调减为0.79亿元，将2023年一季度、半年度、三季度归母净利润分别由-0.39亿元、-0.68亿元、-0.52亿元调减为-0.76亿元、-1.27亿元、-2.91亿元，上述调整对当期归母净利润影响重大。2023年，公司研发费用3.60亿元，同比大幅增长167.48%；2024年上半年，公司研发费用1.36亿元，同比继续增长7.85%。

请公司补充披露：（1）未及时入账原材料的具体情况，包括原材料名称、账面价值、主要用途、供应商基本信息、款项支付及货物交付时点、实际存放和最终使用情况，并说明未及时入账的具体原因；（2）研发费用误确认为半成品的具体情况，包括确认的半成品名称、账面价值、形成时点，并结合研发过程和实际核算情况说明未能准确计量研发费用的具体原因；（3）2023年以来研发费用大幅增长的原因、主要用途及流向、形成的具体成果或效益，说明是否存在其他费用核算不准确的情形；（4）结合上述情况，说明公司内部控制是否存在重大缺陷及其体整改措施。请年审会计师发表意见。

【公司回复】

（1）未及时入账原材料的具体情况，包括原材料名称、账面价值、主要用途、供应商基本信息、款项支付及货物交付时点、实际存放和最终使用情况，并说明未及时入账的具体原因

公司未及时入账原材料的具体情况如下：

单位：万元

原材料名称	账面价值	主要用途	供应商基本信息	款项支付时点	货物交付时点	实际存放和最终使用情况
碳化硅晶体150	315.00	碳化硅衬底相关生产	湖州华与非进出口有限公司	2022年8月	2022年8月	于2022年8月被生产使用
	315.00			2022年8月	2022年11月、2022年12月	于2022年11月、2022年12月被生产使用
碳化硅籽晶153	44.00	碳化硅衬底相关研发		2022年8月	2022年8月	于2022年8月被研发使用
碳化硅晶体150	325.28	碳化硅衬底相关生产		2022年10月	2022年10月	于2022年10月被生产使用
碳化硅籽晶153		碳化硅衬底相关研发				于2022年10月被研发使用
碳化硅籽晶155						
碳化硅晶体150	359.50	碳化硅衬底相关生产		2022年10月	2022年10月	于2022年10月被生产使用
碳化硅晶体8寸	7.00	碳化硅衬底相关研发		2022年10月	2022年10月	于2022年10月被研发使用
碳化硅籽晶153	164.18	碳化硅衬底相关研发		2022年11月	2022年11月	于2022年11月被研发使用
碳化硅籽晶155		碳化硅衬底相关研发				
碳化硅晶体150	371.55	碳化硅衬底相关生产		2022年11月	2022年10月、2022年11月	于2022年10月、2022年11月被生产使用
碳化硅晶体150	448.81	碳化硅衬底相关生产		2022年12月	2022年11月、2022年12月	于2022年11月、2022年12月被生产使用
碳化硅籽晶153	3.53	碳化硅衬底相关研发		2022年12月	2022年12月	于2022年12月被研发使用
碳化硅晶体150	365.92	碳化硅衬底相关生产		2023年2月	2023年2月	于2023年2月被生产使用
碳化硅籽晶153	71.63	碳化硅衬底相关研发		2023年2月	2023年2月	于2023年2月被研发使用
碳化硅晶体150	389.34	碳化硅衬底相关生产		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被生产使用
碳化硅籽晶153	62.33	碳化硅衬底相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被研发使用
碳化硅晶体150	360.82	碳化硅衬底相关生产		2023年3月	2023年5月	于2023年5月被生产使用
碳化硅晶体150	470.64	碳化硅衬底相关生产		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被生产使用
碳化硅籽晶153	74.49	碳化硅衬底相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被研发使用
碳化硅晶体150	1,061.38	碳化硅衬底相关生产		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被生产使用
碳化硅籽晶153	177.60	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅籽晶200 D级	74.43	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅晶体150	886.81	碳化硅衬底相关生产	上海纽卡帕科技有限公司	2023年8月	2023年8月	于2023年8月被生产使用
碳化硅籽晶160	521.83	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅粉	16.81	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅晶体150	613.66	碳化硅衬底相关生产		2023年9月	2023年8月	于2023年8月被生产使用
碳化硅籽晶160	623.46	碳化硅衬底相关研发		2023年9月	2023年8月	于2023年9月被研发使用
碳化硅籽晶200 P级	43.05	碳化硅衬底相关研发		2023年9月	2023年8月	于2023年9月被研发使用
碳化硅籽晶200 D级	197.37	碳化硅衬底相关研发		2023年9月	2023年8月	于2023年9月被研发使用
钨粉	38.28	钨丝金刚线相关研发	湖州华与非进出口有限公司	2022年11月	2022年11月	于2023年第一季度被研发使用
钨粉	70.76	钨丝金刚线相关研发		2022年12月	2022年12月	于2023年第一季度被研发使用
拉丝石墨乳						
氧化镧						
氢氧化镧	0.77	钨丝金刚线相关研发		2022年12月	2022年12月	于2023年第一季度被研发使用
氢氧化镧	0.77	钨丝金刚线相关研发		2023年1月	2023年1月	于2023年第一季度被研发使用
氧化镧	0.08	钨丝金刚线相关研发		2023年1月	2023年1月	于2023年第一季度被研发使用
氧化镧	0.06	钨丝金刚线相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年第一季度被研发使用
拉丝石墨乳	0.23	钨丝金刚线相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年第一季度被研发使用

公司子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）分别于2022年9月、2023年1月与下游客户T签订6英寸碳化硅衬底销售合同，约定在2023年底前应交付6英寸碳化硅衬底合计超15万片。但公司自有长晶产能无法满足订单及研发需求，故公司外购一部分碳化硅晶体、籽晶，进行后道切磨抛加工，公司未将该部分原材料及时入账。直至2023年底，公司已确定无法完成上述合同的交付计划，故于2024年1月与客户签订补充协议明确违约责任和后续合作事宜。

2022年底2023年初，公司光伏业务中的钨丝金刚石切割线正在研发中，基于商业考量，公司不便让竞争对手知晓公司在进行钨的冶炼研究，故通过湖州华与非进出口有限公司这家贸易公司购买钨粉、氧化镧等原材料，因供应商未及时开票给公司且金额较小，原材料未及时暂估入账。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对公司前期会计差错进行更正，追溯调整了上述事项影响的存货及成本费用等相关会计报表项目。

（2）研发费用误确认为半成品的具体情况，包括确认的半成品名称、账面价值、形成时点，并结合研发过程和实际核算情况说明未能准确计量研发费用的具体原因

1、公司各报告期追溯调整为研发费用的半成品的具体情况如下：

单位：万元

报告期	半成品名称	账面价值	形成时点
2022年度	碳化硅晶锭（料号B161-1001512-01F）	365.36	2022年4月
	碳化硅晶锭（料号B111-1001020-02F）	32.00	2022年5月
	碳化硅晶体（料号YB162-0000600-01F）	1,204.28	2022年12月
	碳化硅晶体（料号B162-0000600-01F）	192.90	2022年12月
2023年第一季度	碳化硅晶体（料号B162-0000600-01F）	64.26	2023年1月
2023年第二季度	碳化硅晶锭（料号B161-1001512-01F）	664.29	2023年4月
		1,328.57	2023年5月
	衬底线切片（料号YB163-0005049-01F）	1,829.83	2023年6月
2023年第三季度	碳化硅晶锭（料号B161-1001512-01F）	431.79	2023年7月
		631.07	2023年8月
		1,395.00	2023年9月

2、未能准确计量研发费用的具体原因

2022年至今，公司半导体业务主要进行6英寸导电型碳化硅衬底片研发及相关工艺的优化。2022年，公司陆续将样品送去下游客户T做验证，在客户端反馈良好，2022年9月，东尼半导体与下游客户T签订2万片6英寸碳化硅衬底的订单，该业务2022年度实现营业收入1,676.56万元。2023年第一季度，研发部门通过调整籽晶在长晶炉中的位置、长晶功率以及保温等方式，保证生长条件的稳定性，改善晶片外观问题，2023年1月，东尼半导体与下游客户T签订13.5万片6英寸碳化硅衬底的年度订单。2023年第二季度，研发部门通过软件模拟的方式，优化热场结构设计，保证温度分布的均匀性，改善位错问题。2023年第三季度，长晶工艺重新开发，以应对检测设备更换的问题，进行SF良率的改善。2023年度，半导体业务实现营业收入12,940.92万元。2024年开始碳化硅衬底材料的主要需求又从SBD级发展到技术指标要求更高的MOS级，半导体业务2024年上半年主要进行高规格6英寸和8英寸衬底的研发验证工作，半年度实现营业收入4,129.34万元。

公司自2022年1月1日起按照财政部发布的企业会计准则解释第15号，对半导体业务研发过程中产出的研发制品，在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量其成本并确认为存货，同时冲减研发费用。2023年6月，东尼半导体与下游客户T沟通发现，双方产品检测设备不同导致SF的判断标准不一致，使得得出的TUA数据不一致，并于2023年7月邮件确认上述问题引起的2023年交付计划的差异不视为违约。问题出现后，公司与下游客户T关于技术指标检测、设备工艺调整等一直保持沟通，直至2024年1月，与下游客户T签订补充协议对违约责任和后续合作事宜做了相关约定，具体情况详见公司于2024年1月披露的《东尼电子关于重大合同的进展公告》及补充公告（公告编号：2024-002、2024-003）。至此，公司明确所涉产品预计在后期存在无法使用的可能，基于谨慎性原则，公司对2022年度、2023年第一至第三季度在研发阶段转入的有关半成品追溯调整为研发费用。

（3）2023年以来研发费用大幅增长的原因、主要用途及流向、形成的具体成果或效益，说明是否存在其他费用核算不准确的情形

1、公司2023年以来研发费用的具体情况如下：

单位：万元

主要用途及流向	2024年半年度研发费用	2023年度		形成的具体成果或效益
		研发费用	同比变动（%）	
消费电子	1,753.31	5,368.04	26.57	2023年至2024年半年度，该业务取得专利11项（其中发明专利1项，实用新型10项）。 主要针对无线充电隔磁材料的配套研发改进，根据国际大客户的产品迭代要求，改造优化各制程工序的模治具及自动化设备的设计方案及运营稳定性，对消费电子业务2023年度毛利率提升，2024年半年度营收和毛利增长起到促进作用。
光伏	4,834.13	9,660.68	225.61	2023年至2024年半年度，该业务取得专利2项（其中发明专利1项，实用新型1项）。 研发进行中，尚未形成显著效益。
新能源	1,849.02	4,679.81	112.42	2023年至2024年半年度，该业务取得专利20项（其中发明专利2项，实用新型18项）。 主要针对新项目柔性线路板相关产品和工艺的研发，解决产品式样及工艺设计、端子压接、集成母排直连等技术领域的一系列问题，并研发了直连接技术和铝基导体FPC，对2024年半年度部分新能源客户的定点项目批量供货、营收大幅增长起到促进作用。
医疗	199.35	478.96	25.23	2023年至2024年半年度，该业务取得专利4项（其中发明专利1项，实用新型3项）。 主要针对已有产品的配套研发改进，对医疗业务2023年度毛利率提升、2024年半年度营收和毛利增长起到促进作用。
半导体	4,947.59	15,839.62	330.94	2023年至2024年半年度，该业务取得专利7项（其中发明专利2项，实用新型5项）。 研发进行中，尚未形成显著效益。
总计	13,583.41	36,027.12	167.48	/

2、公司2023年以来研发费用大幅增长，主要系半导体、光伏和新能源业务的研发投入大幅增加所致，具体原因如下：

（1）半导体业务：碳化硅衬底材料为第三代半导体的核心材料之一，尚处于快速发展阶段，技术指标更新较快，质量要求不断提高，且公司2023年6月又发现主要下游客户的检测设备从SICA88转为candela8520，由于两款检测设备的检测方式不同，对SF的检测结果不